

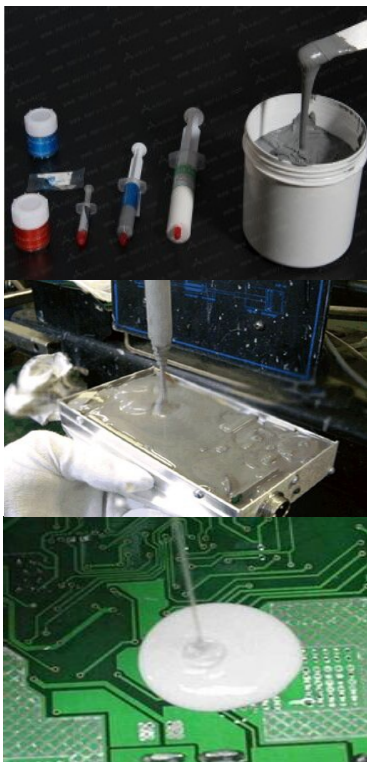
# ZERO<sup>®</sup> -TSP1200

## 双组份环氧树脂导热材料

TSP1200是一种双组份、高导热性、可室温固化、较长工作时间、有防火性能的环氧树脂灌封胶。它特别适用于电容器,小型电子器材的灌封。

### 特点/好处

- 优良的耐热冲击性能
- 良好的耐溶剂、防水性能
- 较低的粘度,易于气体排放
- 良好的绝缘性能,表面光滑



### 典型应用

继电器汽孔封密

磁心黏贴; 尖端型LED

LCD气孔封口; 热传感器; 电抗器灌封

光学及医疗配件粘合; 医疗金属针嘴固定

汽车点火器灌封; 汽车安定器; 温度探测器灌封

### 可供规格

产品尺寸:

10公斤/每罐(A/B各一组)

25公斤/每罐(A/B各一组) 具体按实际包装为准, 量大可定制

Model 型号		TSP1200A	TSP1200B	Test Method
<b>特性 PROPERTY</b>				
颜色 Color(Adjustable)		gray	White	Visual
相对密度 g/cm <sup>3</sup>		1.56±0.05	1.56±0.05	ASTM D792
粘度 CPS		1500-2500	1500-2500	ASTM D149
使用比例		1:1		--
混合后粘度25℃ CPS		1500-2500		--
混合后操作时间min 25℃		70-150		--
初步固化时间hr 25℃		2.5		--
完全固化时间hr 25℃		5		--
60℃温度下固化时间(MIN)		25		--
固化后	硬度shore A	40-50		ASTM D412
	介电强度(KV/MM)	≥15		ASTM D412
	介电常数(1.0MHz)	2.4-3.0		ASTM D2240
	体积电阻率(Ω·CM)	≥1.0*10 <sup>13</sup>		--
	使用温度范围℃	-40-150		--
	阻燃等级UL94	V-0		U.L E464456
	导热系数W/m·k	≥0.6		ASTM D5470
	击穿电压(KV/AC)	≥6		ASTM D149
1)All data are provided by ZERO laboratory,Since the performance standards and specifications are different for each product,please ask for details from ZERO.				
2)Before using the product, please be sure to test in advance. Besides our silicone products are used for general industrial use, not for human transplantation or implantation body.				

以上数据由零度导热实验室提供, 该实验室保留最终解释权。